

华泰联合证券有限责任公司
关于苏州锴威特半导体股份有限公司
2026 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：锴威特
保荐代表人姓名：牟晶	联系电话：021-38966919
保荐代表人姓名：吕瑜刚	联系电话：021-38966911

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“锴威特”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，对锴威特进行持续督导，并针对公司 2026 年 1-6 月（以下简称“报告期”）的相关事项出具本持续督导跟踪报告：

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

二、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）业务亏损的风险

受全球经济增速放缓及行业竞争加剧影响，产品售价与毛利率承压，公司净利润仍处于亏损状态；同时，公司坚持前瞻性战略布局，持续加大研发投入以覆盖全品类功率器件、推动功率IC及第三代半导体产品系列化，并加强市场推广与渠道建设。未来若市场需求波动、竞争加剧或产品迭代加速，而公司未能持续提

升竞争力或充分释放规模效应，可能导致营业收入大幅波动并延长亏损周期，进而对现金流、财务状况产生不利影响。尽管公司已采取降本增效措施，但若无法有效应对前述挑战或控制成本，仍将面临业绩持续亏损的风险。

（二）核心竞争力的风险

1、新产品研发及产业化不及预期的风险

半导体行业的研发存在周期较长、工艺复杂等特点，产品技术优化升级需要持续的资源投入。由于新品研发至实现规模销售需要一定的时间周期，公司功率器件、功率IC新产品的研发进度及研发成果实现产业化都存在不确定性。如果新产品研发及产业化进度未达预期或无法在市场竞争中占据优势，公司将面临新产品研发及产业化失败的风险，前期的研发投入也将无法收回，给公司未来业务拓展带来不利影响。

2、技术泄密的风险

集成电路设计行业为技术密集型行业，核心技术是行业内企业保持领先优势的重要保障，对企业发展具有重要作用。基于多年的技术积累和研发投入，公司在功率半导体领域已形成多项核心技术，并广泛应用于自有产品中，同时公司正致力于新技术和新产品的研发。如果公司核心技术人员流失或个别人员核心资料保管不善，则可能导致公司核心技术失密的风险。若公司核心技术泄密，并被竞争对手所获知和模仿，则可能会削弱公司的竞争优势，并对公司生产经营带来不利影响。

（三）经营风险

1、晶圆委外加工及产能供应稳定性的风险

目前，公司采用Fabless经营模式，专注于芯片的设计、研发和销售环节，而将晶圆制造、封装测试等生产环节委托供应商进行。若晶圆代工、封装测试等委外加工价格大幅上涨，或因晶圆代工厂、封装测试厂产能紧缺或工艺波动等原因影响公司产品供给，将对公司供应稳定性、盈利能力造成不利影响。若未来公司与主要晶圆供应商的合作关系发生不利变化，或主要供应商由于产能受限等原因而降低对公司的产能供给，而公司在短期内无法及时寻找新的晶圆供应商并快速

获取产能形成稳定供应，将影响公司晶圆供应的稳定性，从而对公司生产经营造成不利影响。

2、供应商集中度较高的风险

目前，公司采用Fabless经营模式，专注于芯片的设计、研发和销售环节，而将晶圆制造、封装测试等生产环节委托供应商进行。由于资金、技术等壁垒，半导体行业内符合公司技术和工艺要求的晶圆代工厂数量较少。若未来公司主要供应商出现产能受限、自身生产经营或与公司合作情况发生不利变化等情况，公司在短时间内替换供应商存在较大困难，可能导致公司不能足量、及时出货，从而对公司生产经营造成不利影响。

3、关键技术人员流失的风险

目前国内半导体企业众多，对功率半导体关键技术人员需求缺口较大，运用高薪或者股权激励等方式吸引技术人员已逐渐成为行业内的常规手段，导致行业内人员流动愈发频繁。未来，如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势或人才发展及内部晋升受限，公司对关键技术人才的吸引力将减弱，甚至可能出现现有关键技术人员流失的情形，对公司生产经营产生不利影响。

（四）财务风险

1、收入增长可持续性的风险

虽然本报告期收入较上年同期有较大幅度的增加，但若未来半导体行业市场供需关系发生调整或者市场竞争持续加剧导致公司不能保持产品的核心竞争力和市场竞争优势，则会对公司产品售价、销量造成负面影响，并可能导致客户订单执行延缓或出现违约、主要客户流失，从而使公司面临收入增长可持续性的风险。

此外，公司功率IC产品主要面向高可靠领域，客户集中度较高，且该领域客户订单在一定程度上会受到年度预算和终端需求等因素的影响。若未来客户订单延迟或取消、公司未能准确把握行业技术发展趋势或下游市场需求发生重大不利变化等，可能导致公司功率IC业务出现新客户拓展不达预期、现有客户流失等情形，从而使公司面临收入增长可持续性的风险。

2、毛利率及盈利能力下降的风险

受宏观经济环境、地缘政治变局、行业周期等不利因素的扰动，报告期内公司主要产品存在毛利率波动的情况。随着市场需求的变化和行业技术的发展，若公司未能正确判断市场需求变化、技术水平停滞不前、未能有效控制产品成本或市场竞争格局发生不利变化，将会导致公司产品售价和成本出现预期外的波动，公司产品毛利率及盈利能力未来存在下降的风险。

3、存货滞销及减值的风险

随着业务规模的不断扩张，公司产品类别较多，产品型号丰富，虽然一定程度上可以满足更广泛的客户需求，但也带来了一定的风险。各类产品面对的市场竞争、产品周期和迭代进度均有差异。若未来下游领域需求端持续低迷或市场环境发生其他不利变化、客户临时改变需求、竞争加剧或技术升级，或者公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理，导致产品滞销、周转天数延长、存货积压，公司可能面临存货滞销及减值的风险。

4、应收账款增加的风险

随着经营规模的不断扩大，公司应收账款余额有所增加。应收账款是公司流动资产的重要组成部分，其管理效率直接影响到公司的现金流状况和财务健康。良好的应收账款管理可以确保公司及时收回款项，维持健康的现金流，支持日常运营和未来发展。若未来下游需求端低迷或市场环境发生其他不利变化，公司不能有效加强应收账款的催收，导致应收账款增加，则公司可能面临发生坏账的风险，进而会对公司的盈利能力产生不利影响。

5、公司期间费用增加的风险

根据本公司战略发展规划，未来在新产品开发、新市场拓展以及业务布局上需要充足资金支撑公司业务发展，并且随着业务规模的扩大，研发、销售、管理成本均有所提高，财务费用也将增加，将会对公司盈利能力造成一定影响。

（五）行业风险

1、技术迭代风险

公司主要经营的产品包括功率器件和功率IC，两者均属于功率半导体。功率半导体行业属于技术密集型行业，不追求先进制程，产品生命周期长，较数字芯片相比迭代速度慢。从技术发展层面来看，一方面，下游客户的个性化需求不断丰富，下游应用领域对产品技术参数要求亦不断提升，如公司无法顺应行业技术发展趋势，在产品研发中紧跟下游客户应用需求的变动方向，则有可能导致公司产品被赶超或替代。

2、市场竞争风险

目前，我国的功率半导体行业正经历快速发展阶段，行业内厂商积极进行市场拓展，市场竞争逐渐加剧。公司所处行业的竞争对手较多，既包括英飞凌、安森美等国际一流功率半导体厂商，也包括华润微、士兰微等国内的知名功率半导体厂商。公司需要持续投入大量资金用于核心技术及新产品的研发，以缩小与竞争对手的差距并保持自身竞争力。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时推出新产品、不断优化产品性能与提高服务质量，则可能导致公司竞争能力下降，公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能受到不利影响。

（六）宏观环境风险

1、国际贸易摩擦的风险

在经济全球化日益深化的背景之下，国际贸易关系的变化对于半导体行业景气度可能产生深远影响。部分国家通过贸易保护的手段，试图制约中国相关产业的发展；尤其是随着中美贸易摩擦的加剧，美国政府已将多家中国企业和机构列入美国出口管制的“实体清单”。若美国将公司及公司主要客户、供应商列入“实体清单”名单或采取其他经济限制手段，可能导致公司业务受限、供应商无法供货或者客户采购受到约束，公司的正常生产经营将受到不利影响。同时，半导体产业链上下游可能出现生产和采购受限的情形，从而对公司经营业绩造成不利影响。

2、产业政策变化风险

半导体产业是国家战略性产业。近年来，国家出台了一系列鼓励政策以推动

我国半导体产业的发展，增强了中国半导体产业的创新能力和国际竞争力，带动了整个产业的发展。但若未来国家相关产业政策支持力度减弱，可能导致下游市场需求下滑、税收优惠减少、政府补贴金额下降等，公司的经营业绩可能会因此受到不利影响。

（七）重大资产重组相关风险

公司已于2026年8月6日披露《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买晶艺半导体有限公司100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。本次交易尚需经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可正式实施。相关事项仍在有序推进过程中，本次交易能否取得前述批准、审核通过或同意注册以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。

三、重大违规事项

无。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

本报告期公司主要会计数据及主要财务指标如下：

主要会计数据	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期较上年同期增减（%）
营业收入（万元）	16,098.01	11,103.00	44.99
利润总额（万元）	-3,404.36	-3,523.43	不适用
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-3,385.15	-3,322.39	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	-3,808.81	-3,795.97	不适用
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-7,616.39	-1,279.89	不适用
主要会计数据	2026 年 6 月末	2025 年末	本期末较上年末增减（%）

归属于上市公司股东的净资产（万元）	76,083.24	79,465.73	-4.26
总资产（万元）	91,671.38	93,569.33	-2.03
主要财务指标	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期较上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.46	-0.45	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.46	-0.45	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.52	-0.52	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-4.35	-3.80	减少 0.55 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.90	-4.34	减少 0.56 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	25.50	31.75	减少 6.25 个百分点

1、公司营业收入大幅变动的主要原因系订单增加所致。

2、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系扩大产能，采购产品货款增加所致。

五、核心竞争力的变化情况

（一）公司核心竞争力的具体体现

1、公司的研发和技术优势

公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家鼓励的重点集成电路设计企业，江苏省“科技小巨人企业”“江苏省潜在独角兽企业”、江苏省半导体行业协会理事单位，公司研发中心获“江苏省高可靠性功率器件工程技术研究中心”认证。

在功率器件方面，公司积累了包括“高可靠性元胞结构”“新型复合终端结构及实现工艺技术”“一种利用Power MOS管实现高压快速启动的AC-DC开关电源的实现方法”等多项核心技术，其中3项达到国际先进水平，1项达国内领先水平，使公司产品关键技术指标达到了与国际领先厂商同类产品的水平；在功率IC方面，公司与晶圆代工厂深度合作，可根据晶圆代工厂的标准工艺调整工艺参数和流程，进一步优化产品性能。公司已形成百余款功率IC产品，并完成了多款功率IC所需的IP设计与验证；公司自主研发了“一种全电压范围多基准电压同步调整电路及

高精度过压保护电路”“一种输入失调电压自动修正电路”等核心技术，有效提升了产品参数一致性，增强了产品可靠性。

2、丰富的产品矩阵

公司坚持“自主创芯，助力核心芯片国产化”的发展战略，公司目前具有功率 MOSFET、隔离 AC-DC 或者 DC-DC、非隔离 DC-DC、栅极驱动、理想二极管、浪涌抑制、高边电流采样、数字隔离器等多个系列产品。公司平面 MOSFET 产品覆盖 40V~1700V 电压段，已形成低压、中压、高压、超高压全系列功率 MOSFET 产品系列；超结 MOSFET 已完成 600~850V 产品系列化；SGT MOS 已建立 20V~120V 产品平台；公司在第三代半导体功率器件方面，已推出 650V-3300V SiC MOSFET 产品系列；功率 IC 方面，公司基于晶圆代工厂 SOI BCD 工艺建立高可靠芯片设计平台，最高结温可达 200 度，满足高可靠领域的技术需求；基于 0.18um BCD 等工艺建立高性能芯片设计平台，满足工业控制领域的技术需求；功率 MOSFET 与功率 IC 融合产品方面，公司已推出电机驱动用智能功率模块（IPM）系列，以及适配 SiC MOSFET 的固态继电器专用光电转换驱动 IC。公司针对高可靠功率电源模块及电机驱动模块提供各功率段的芯片解决方案能力，致力于成为一站式、全品类覆盖的高性能功率半导体产品供应商。

3、广泛的客户覆盖

公司凭借丰富的产品矩阵、高性能的产品和及时迅速的服务能力，已与超过 600 家客户进行合作，实现了广泛的客户覆盖。近年来不断加大功率 IC 和功率器件产品在高可靠、工业控制和新能源应用领域的客户开拓力度。在高可靠领域，公司客户群已覆盖国内高可靠领域电源龙头企业及国家重点科研院所，并获得众多高可靠领域客户的高度认可；在工业控制领域，公司深挖工业储能、光伏逆变、新能源汽车及充电桩、工业电源等细分应用领域的产品需求，超高压平面 MOSFET、高压超结 MOSFET、SiC MOSFET 等细分产品的产品研发及市场开拓取得良好成效。

（二）公司核心竞争力变化分析

报告期内，未发生导致公司核心竞争力受到严重影响的事件。

六、研发支出变化及研发进展

报告期内研发费用为4,104.79万元，同比增长16.43%，研发投入占营业收入的比例为25.50%。公司持续保持高强度研发投入，紧密围绕市场趋势与客户需求，稳步推进产品研发与迭代升级，技术平台建设取得新进展。截至2026年6月30日，公司研发人员79人，占公司总人数的37.26%。

报告期内，公司在电源管理IC、电机驱动IC、硅基功率MOSFET及SiC器件等方向持续推进研发。电源管理IC方面完成多种隔离拓扑产品系列化，移相全桥控制IC完成AEC-Q100车规级认证；电机驱动IC方面推出面向电动工具、无人机、工业伺服等应用的系列产品及IPM模块；硅基功率MOSFET方面进一步完善沟槽MOSFET及SGT MOSFET工艺平台；SiC器件方面与国内晶圆代工厂合作开发并优化750V、900V、1200V、1700V、2600V、3300V SiC MOSFET生产工艺平台。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会于2023年7月7日出具的《关于同意苏州锘威特半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1512号），公司获准向社会公开发行人民币普通股A股1,842.1053万股，每股发行价格为人民币40.83元，募集资金总额为75,213.16万元；扣除发行费用共计8,733.27万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为66,479.89万元，上述资金已于2023年8月14日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年8月14日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000479号）。

截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行	银行账号	截止日余额	备注
宁波银行股份有限公司	75120122000667875	2,870.39	募集资金专户

张家港支行			
中国建设银行股份有限公司张家港分行	32250198623600003914	5,763.28	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行	1102028129000182958	1,537.46	募集资金专户
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	8018288813307	已注销	募集资金专户（注1）
招商银行股份有限公司张家港支行	512905680810818	3,839.26	募集资金专户
华泰证券股份有限公司	666810091693	0	回购专用证券专户
合计		14,010.39	

注 1：鉴于存放在“补充营运资金”专户江苏张家港农村商业银行股份有限公司的募集资金已按规定用途使用完毕，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定将该募集资金专户注销。截至 2024 年 4 月 10 日，公司已完成上述募集资金专户注销手续。

（一）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2025年8月28日召开第三届董事会审计委员会第二次会议及第三届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用最高额度不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款及收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-044）。

（二）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（三）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币/万元

项 目	金 额
一、首次公开发行募集资金总额	75,213.16
减：发行费用	8,733.27
二、首次公开发行募集资金净额	66,479.89
加：使用自有资金支付的发行费用（印花税等）	16.94
三、截止本期累计已使用的募集资金	54,584.53
（一）截止本期末募投项目已使用资金	27,085.10
其中：置换预先投入自筹资金	1,886.06
以前年度募投项目已使用资金	22,125.19
本期募投项目已使用资金	3,073.85
（二）截止本期末累计已使用超募资金	9,999.43
其中：以前年度超募资金永久补充流动资金金额	8,000.00
本期超募资金永久补充流动资金金额	0.00
以前年度超募资金用于股份回购金额	1,999.43
（三）截止期末闲置募集资金进行现金管理余额	17,500.00
（四）募集资金暂时补充流动资金金额	0.00
四、利息收入与现金管理收益	2,099.35
其中：存款利息收入	404.66
现金管理收益	1,694.69
减：手续费支出	1.26
五、截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额	14,010.39

（四）变更募投项目的资金使用情况

公司于2026年3月6日召开了第三届董事会审计委员会第四次会议及第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点、调整实施方式及内部投资结构的议案》，调整涉及新增“功率半导体研发工程中心升级项目”实施地点，并调整实施方式由购置办公楼调整为购置办公楼及租赁厂房，同时调整该募投项目的内部投资结构。该事项已经于2026年3月24日召开的公司2026年第一次临时股东会审议通过。具体详见公司于2026年3月7日在上海证券交易所网站披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于部分募投项目新增实施地点、调整实施方式及内部投资结构的公告》（公告编号：2026-004）。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

无

九、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

（一）控股股东、实际控制人的持股情况

公司的控股股东和实际控制人为丁国华先生。截至2026年6月30日，丁国华先生直接持有公司15.20%股份，同时丁国华作为港晨芯的执行事务合伙人，通过港晨芯间接控制公司6.17%的表决权，根据签署的《一致行动协议》，罗寅、港鹰实业、陈锴系丁国华的一致行动人，罗寅直接持有公司12.82%的股份，港鹰实业直接持有公司7.58%的股份，陈锴直接持有公司5.43%的股份。因此截至2026年6月30日，丁国华先生直接和间接控制公司合计47.20%的表决权。

截至2026年6月30日，公司控股股东、实际控制人持有的公司股份不存在增减变动、质押、冻结及其他减持的情形。

（二）董事和高级管理人员的直接持股情况

截至2026年6月30日，公司董事和高级管理人员直接持有公司的股份情况如下：

序号	姓名	直接持股（万股）	职务或关系
1	丁国华	1,119.8042	董事长
2	罗寅	944.5671	董事、总经理
3	陈锴	400.3350	董事
合计		2,464.7063	-

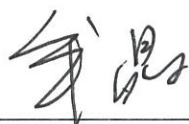
截至2026年6月30日，上述人员直接持有的公司股份不存在质押、冻结及减持的情形。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

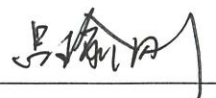
截至本报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州锴威特半导体股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：



牟晶



吕瑜刚

华泰联合证券有限责任公司

2026年 9 月 9 日

